

# 東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2017年3月期第2四半期決算-

2016年11月8日

# 目次

- 1.2017年3月期第2四半期連結決算** **p.2**
- 2.2017年3月期通期連結決算予想** **p.12**
- 3.トピックス** **p.19**  
**～tok中期計画2018の取組み～**

**2017年3月期第2四半期  
連結決算**

# 業績概要

(百万円、%)

	2015/9	2016/9		
			増減	増減率
売上高	44,805	42,897	△1,908	△4.3
営業利益	7,271	5,383	△1,887	△26.0
経常利益	7,441	4,803	△2,638	△35.4
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,898	3,303	△1,595	△32.6

- 期中平均為替 (USDollar) : 120.8円/Dollar (2015/9) ⇒ 103.8円/Dollar (2016/9)
- 売上高 : 高純度化学薬品の売上減に円高の影響等が加わり前年比減収。
- 営業利益 : 期初予想 (2016.5.10発表) を大幅に上回ったが、円高等の影響から、前年比△26.0%減益。
- 経常利益 : 為替に係る差損の拡大等から、前年比△35.4%減益。

# 営業外損益・特別損益

(百万円)

	2015/9	2016/9	前年比
<b>営業外損益</b>	<b>170</b>	<b>△579</b>	<b>△750</b>
受取利息・配当金	+157	+130	△26
(為替に係る差損益)	(△94)	(△891)	(△797)
為替差損益	△37	△1,427	△1,389
デリバティブ評価損益	△57	+535	+592
操業準備費用	△85	—	+85
<b>特別損益</b>	<b>△57</b>	<b>162</b>	<b>+220</b>
投資有価証券売却益	0	+265	+265
減損損失	△51	—	+51
災害による損失	—	△91	△91

# 事業別セグメントの業績

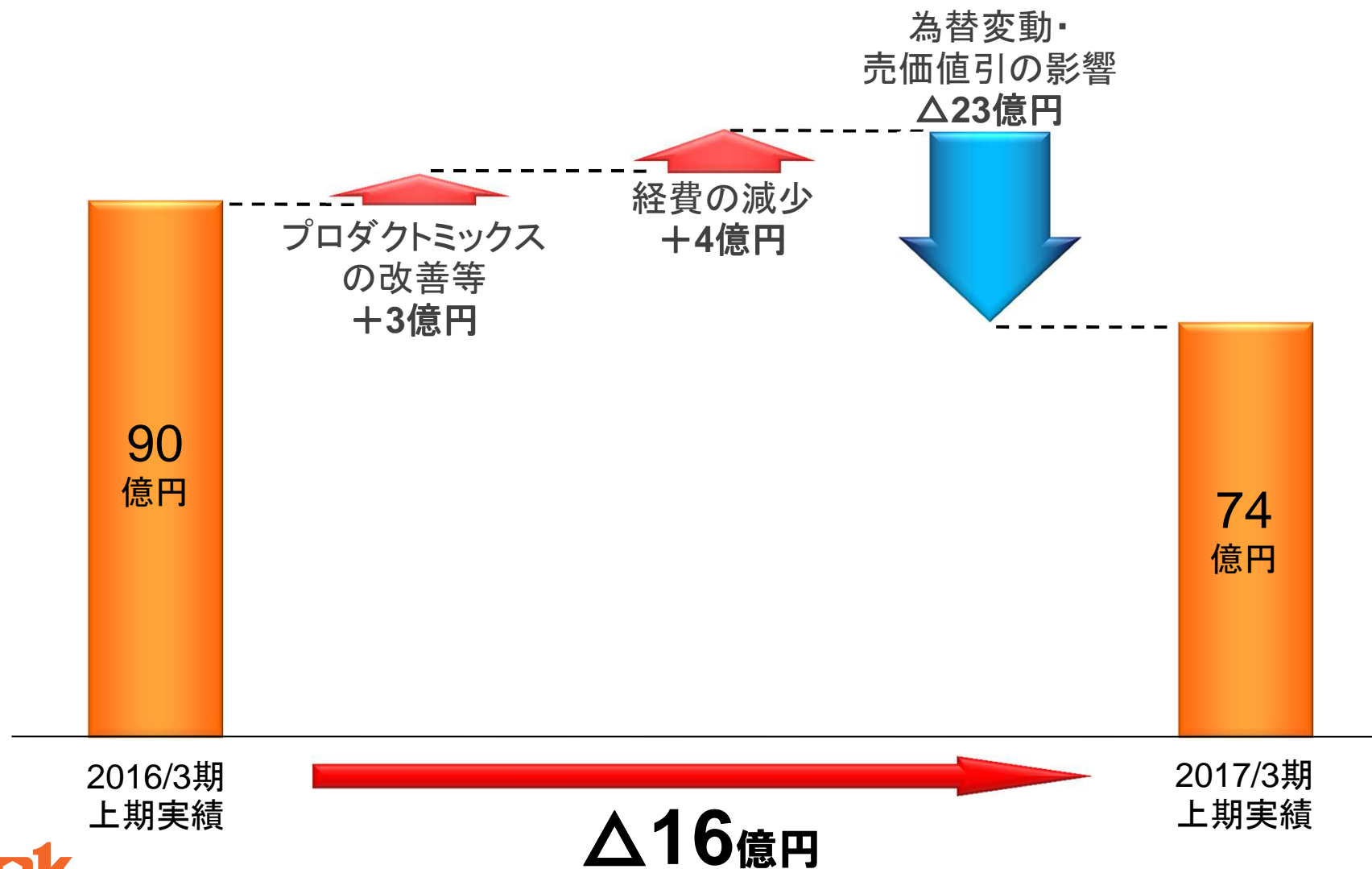
(百万円、%)

	2015/9	2016/9	
		増減	増減率
売上高	44,805	42,897	△1,908 △4.3
材料事業	43,835	41,576	△2,259 △5.2
エレクトロニクス機能材料	25,420	25,822	+402 +1.6
高純度化学薬品	18,309	15,667	△2,642 △14.4
その他	105	86	△19 △18.4
装置事業	969	1,321	+351 +36.2
営業利益	7,271	5,383	△1,887 △26.0
材料事業	9,026	7,356	△1,669 △18.5
装置事業	△139	△178	△39 —
消去又は全社	△1,615	△1,795	△179 —

(注) 装置事業の売上は消去後の数字。

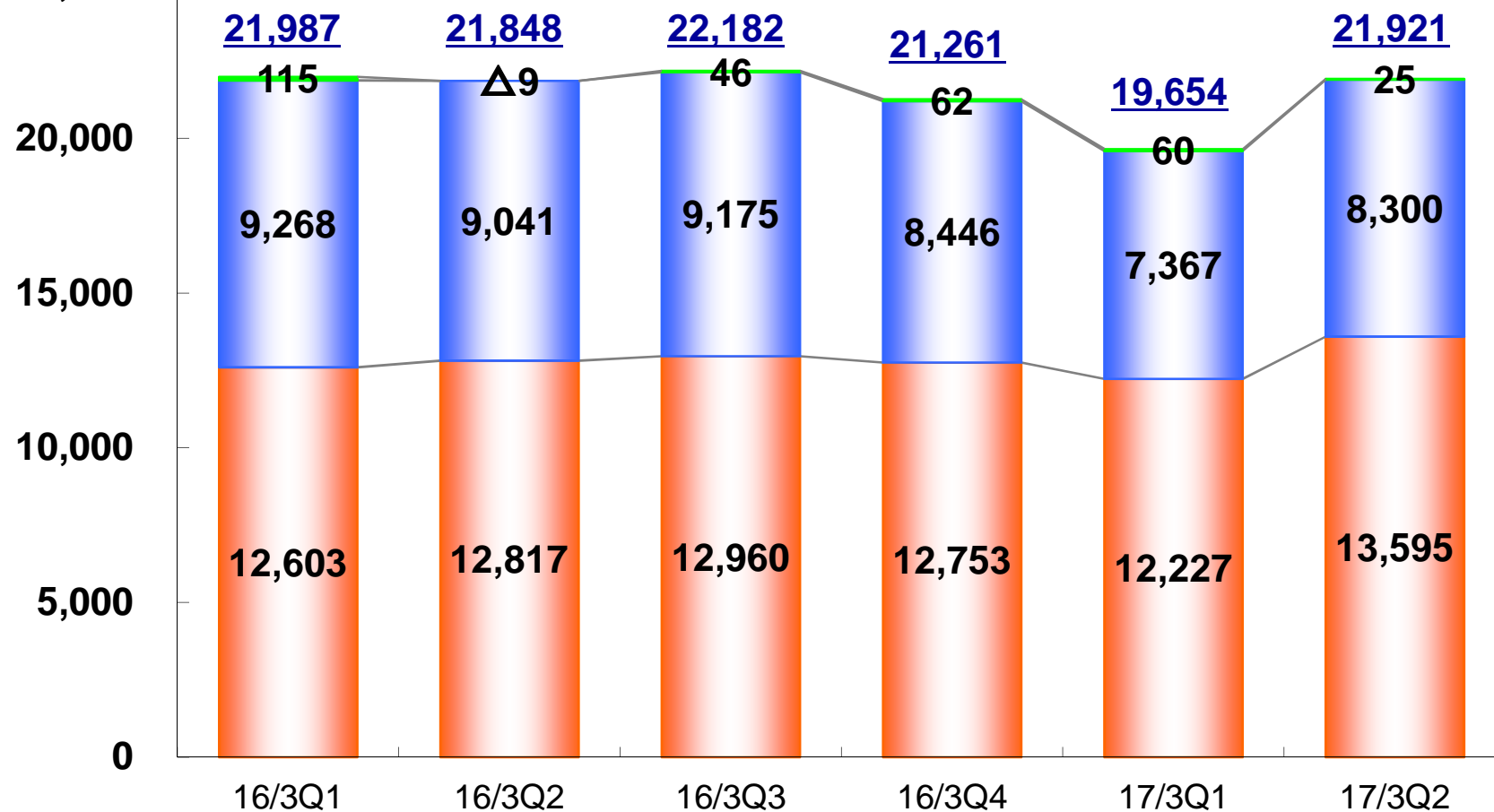
# 営業利益の増減内訳（材料事業）

2016年3月期上期実績 対 2017年3月期上期実績



# 材料事業の売上内訳

売上高  
(百万円)  
25,000



■エレクトロクス機能材料

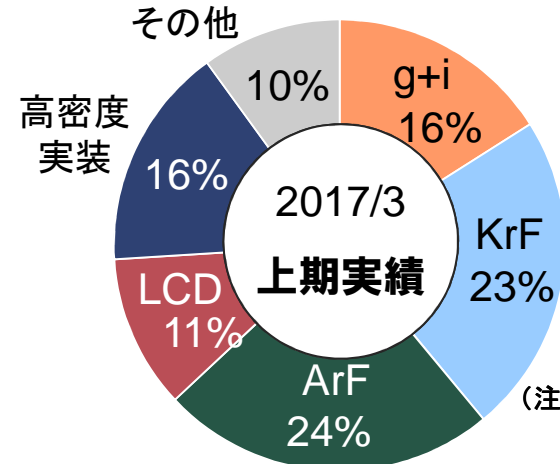
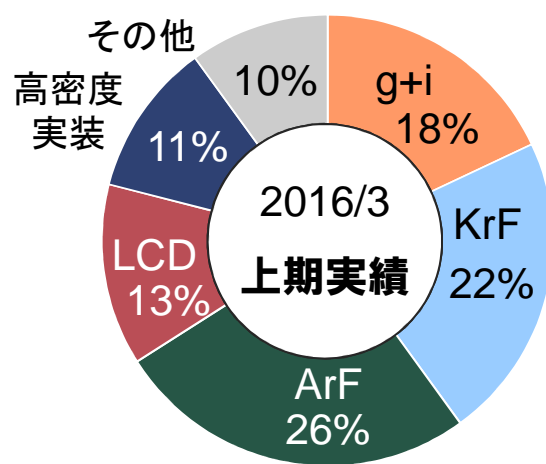
■高純度化学薬品

■その他



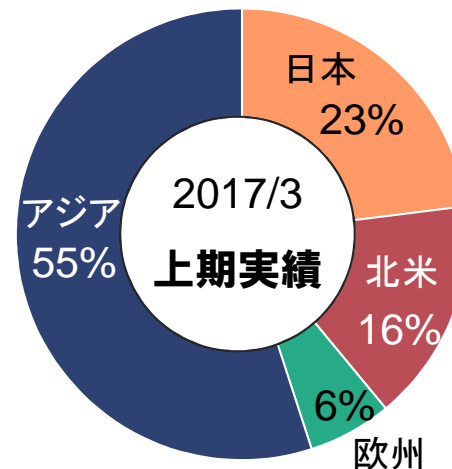
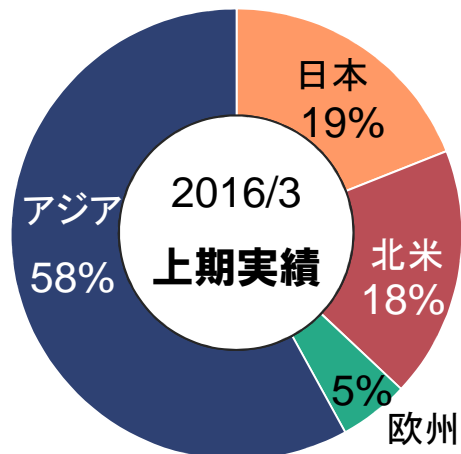
# (ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

## エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



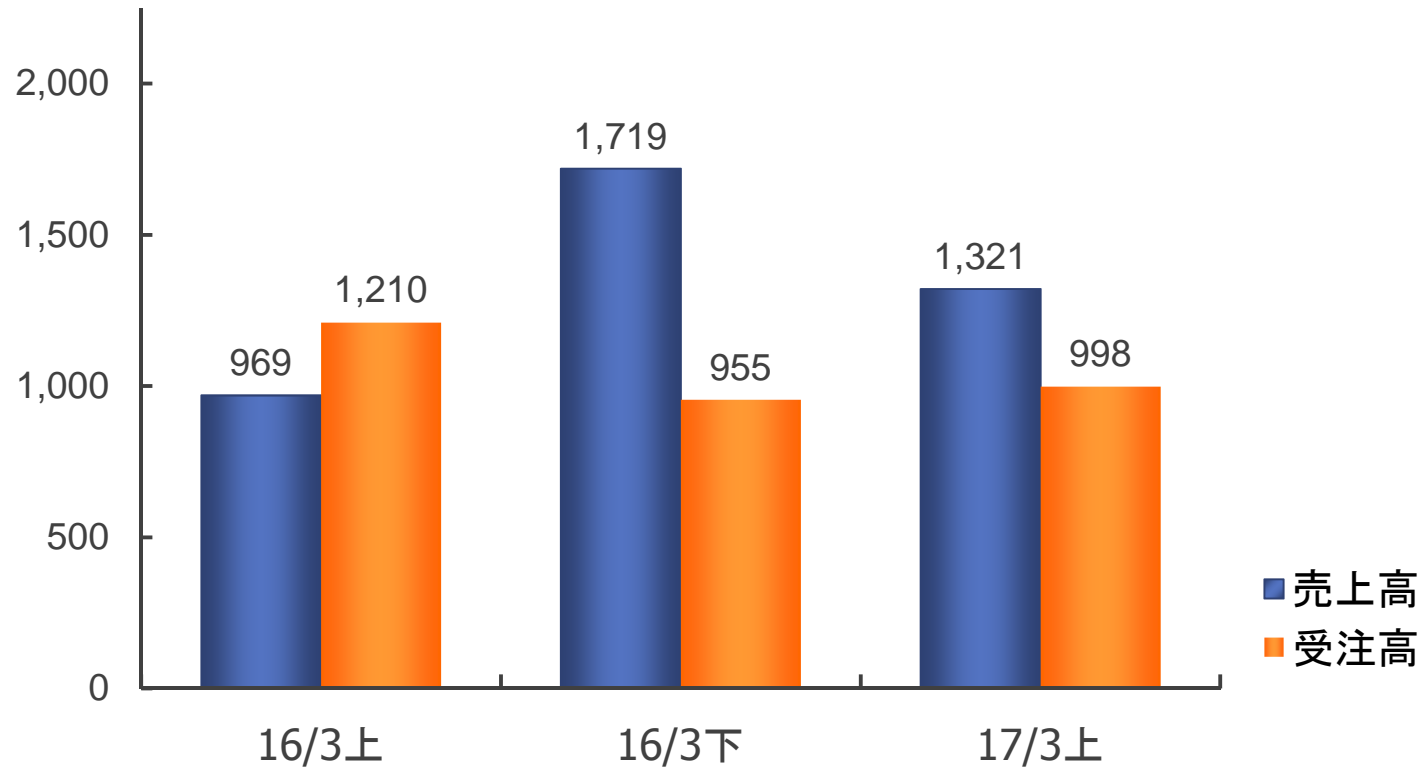
(注) 高密度実装:レジスト材料、MEMS材料

## 半導体フォトレジストの地域別売上構成



# 装置事業

売上高・受注高  
(百万円)



(百万円)	16/3上	16/3下	17/3上
期末受注残高	1,440	1,140	1,016

(注) 装置事業の売上は消去後の数字。

# 比較貸借対照表

(百万円)

	2016/9	16/3末比
流動資産	85,848	△1,265
現金預金	49,257	△1,618
売上債権	18,292	+370
たな卸資産	12,734	△265
有形固定資産	46,905	△1,008
無形固定資産	640	△108
投資その他の資産	30,934	△589
流動負債	17,515	+385
買入債務	7,848	+60
固定負債	1,517	△1,381
純資産合計	145,295	△1,975
総資産	164,328	△2,971

建物及び構築物	△1,029
機械装置	△2,221
工具器具備品	+477
土地	△286
建設仮勘定	+2,065

利益剰余金	+1,789
自己株式	+688
為替換算調整勘定	△3,949

# キャッシュフロー

(百万円)

	2015/9	2016/9
<b>営業キャッシュフロー</b>	<b>+5,774</b>	<b>+5,494</b>
税金等調整前四半期純利益	+7,384	+4,966
減価償却費	+2,685	+2,841
売上債権の増(△)減額	+954	△1,499
たな卸資産の増(△)減額	△790	△740
仕入債務の増減(△)額	△2,624	+457
前受金の増減(△)額	+457	+5
法人税等の支払い	△2,480	△1,219
<b>投資キャッシュフロー</b>	<b>△3,093</b>	<b>△5,180</b>
<b>財務キャッシュフロー</b>	<b>△7,633</b>	<b>△1,261</b>
<b>換算差額</b>	<b>+223</b>	<b>△1,907</b>
<b>現金及び現金同等物の増減(△)額</b>	<b>△4,729</b>	<b>△2,855</b>

主な内訳  
有形固定資産の取得 △4,002

主な内訳  
配当金の支払 △1,381  
(含む非支配株主)

**2017年3月期通期  
連結決算予想**

# 業績予想概要（通期）

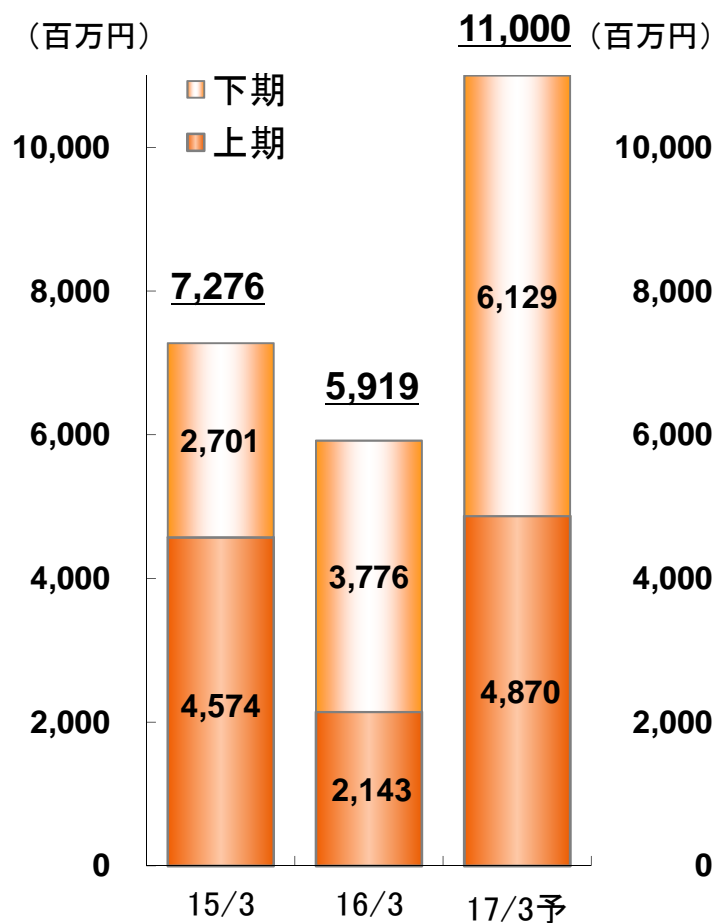
（百万円、％）

	2016/3 実績	2017/3予想		
			増減	増減率
売上高	89,969	87,300	△2,669	△3.0
営業利益	12,438	9,400	△3,038	△24.4
経常利益	12,684	9,400	△3,284	△25.9
親会社株主に帰属 する当期純利益	7,716	6,300	△1,416	△18.4

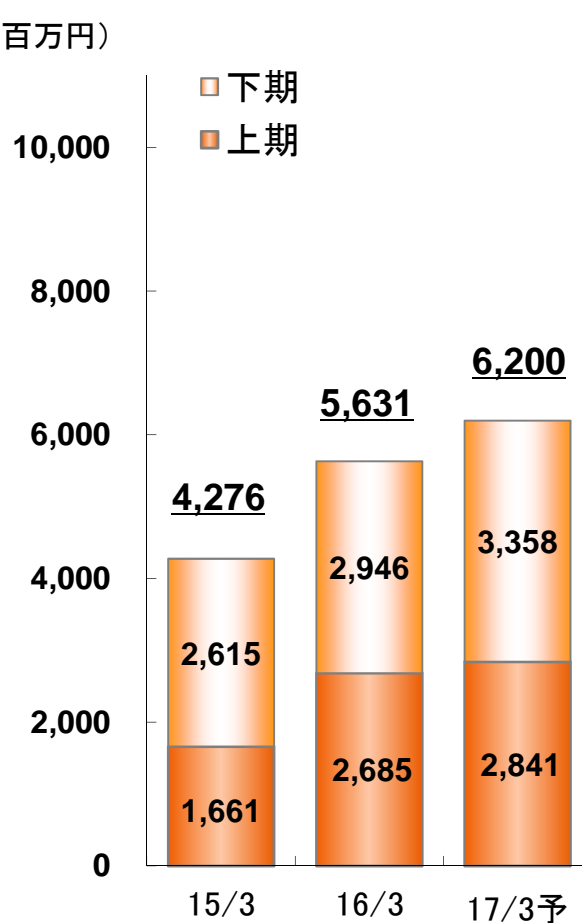
- 為替前提（USドル）：119.3円／ドル（2016/3）⇒105.0円／ドル（2017/3下期）
- 売上高：高密度実装材料、高純度化学薬品が期初予想（2016.5.10発表）を上回るものの、装置事業の増収が想定を下回り、前年比△3.0%の減収予想。
- 営業利益：MIX改善効果等から期初予想は上回るものの、円高等の影響が大きく、前年比△24.4%の減益を予想。

# 設備投資・減価償却・研究開発

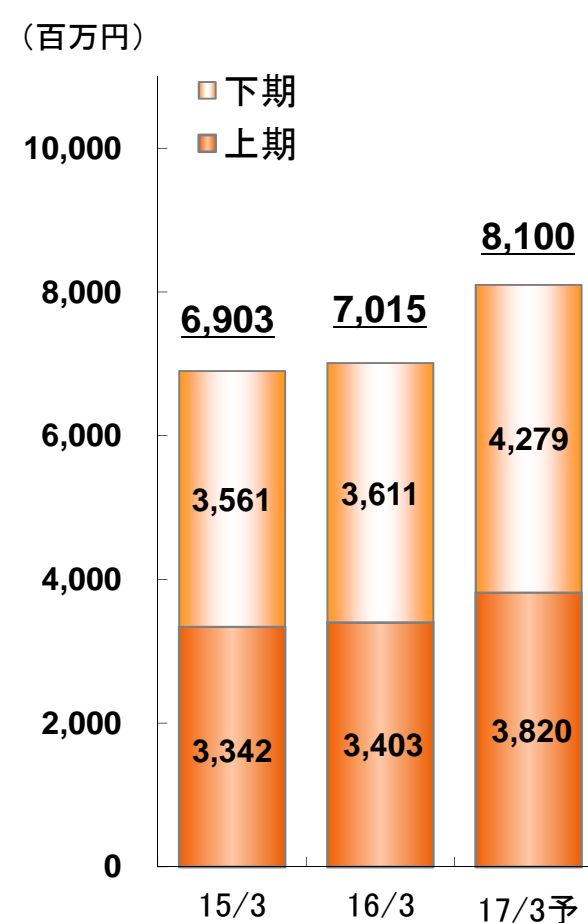
## 設備投資額



## 減価償却費



## 研究開発費



# 事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

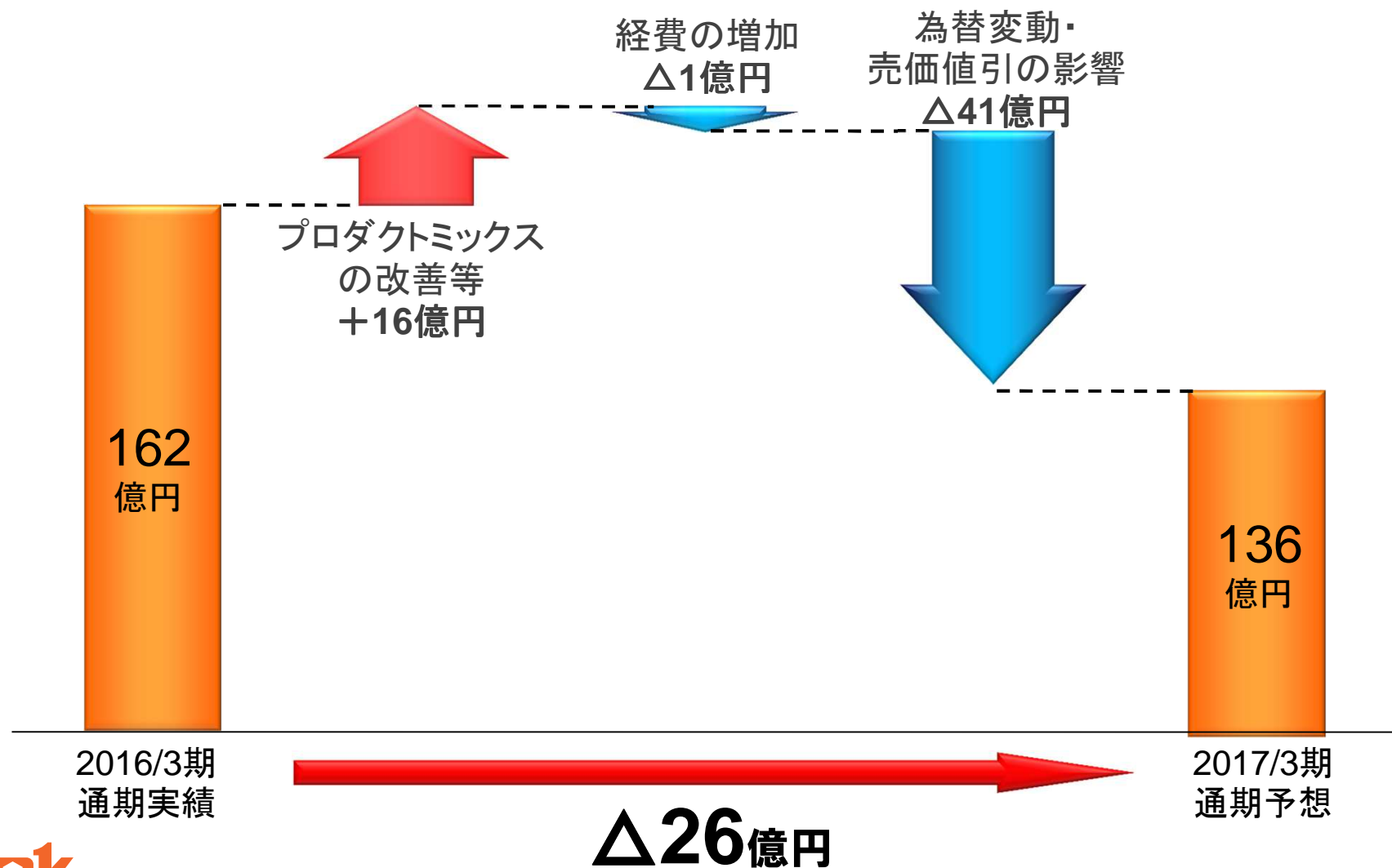
	2016/3 通期実績	2017/3通期予想	
		増減	増減率
売上高	89,969	87,300	△2,669 △3.0
材料事業	87,280	84,100	△3,180 △3.6
エレクトロニクス機能材料	51,134	51,900	+765 +1.5
高純度化学薬品	35,931	32,100	△3,831 △10.7
装置事業	2,689	3,200	+510 +19.0
営業利益	12,438	9,400	△3,038 △24.4
材料事業	16,203	13,600	△2,603 △16.1
装置事業	△423	△400	+23 -
消去又は全社	△3,342	△3,800	△457 -

(注) 装置事業の売上は消去後の数字



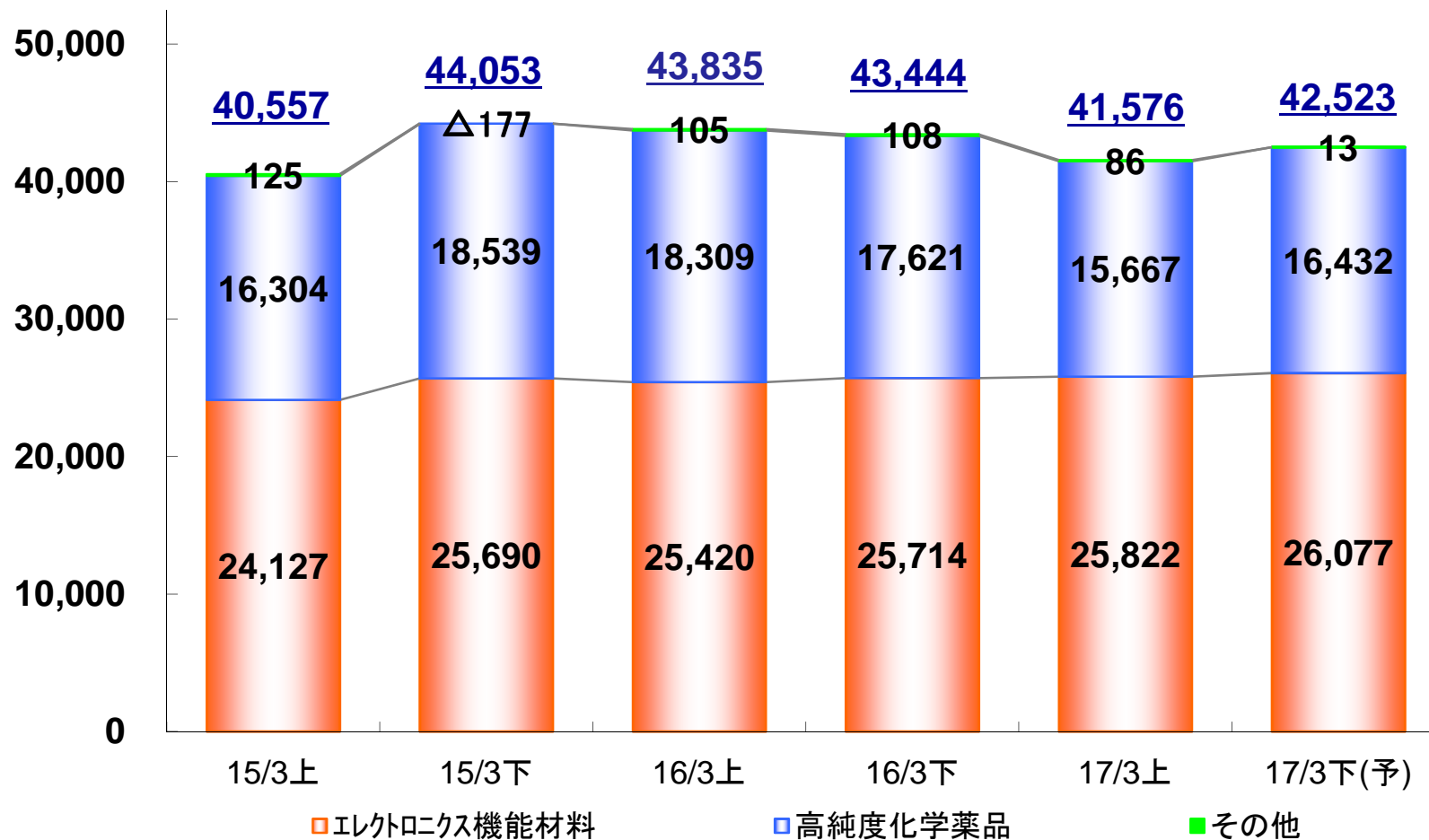
# 営業利益の増減内訳（材料事業）

2016年3月期実績 対 2017年3月期予想



# 材料事業の売上内訳（予想）

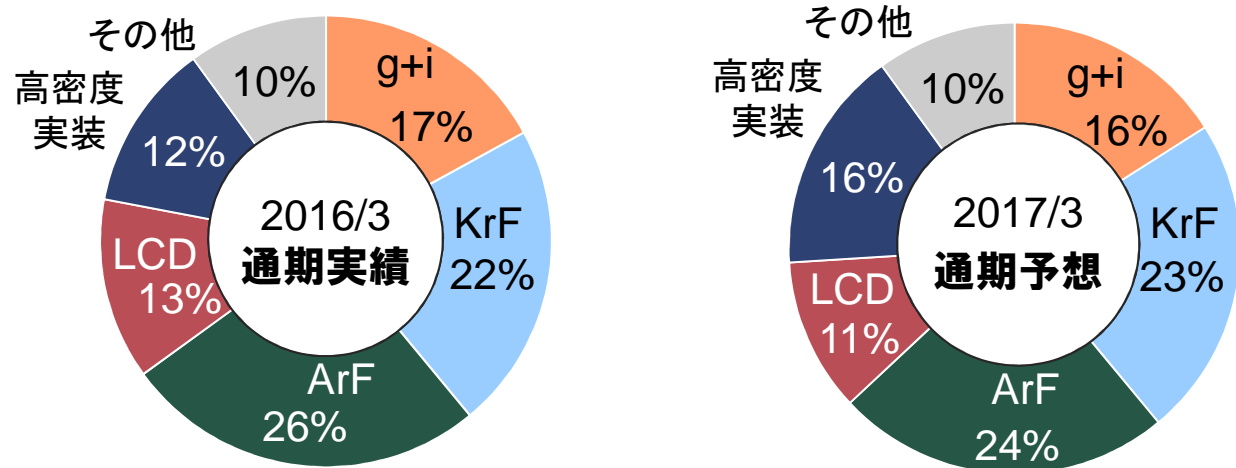
売上高  
(百万円)



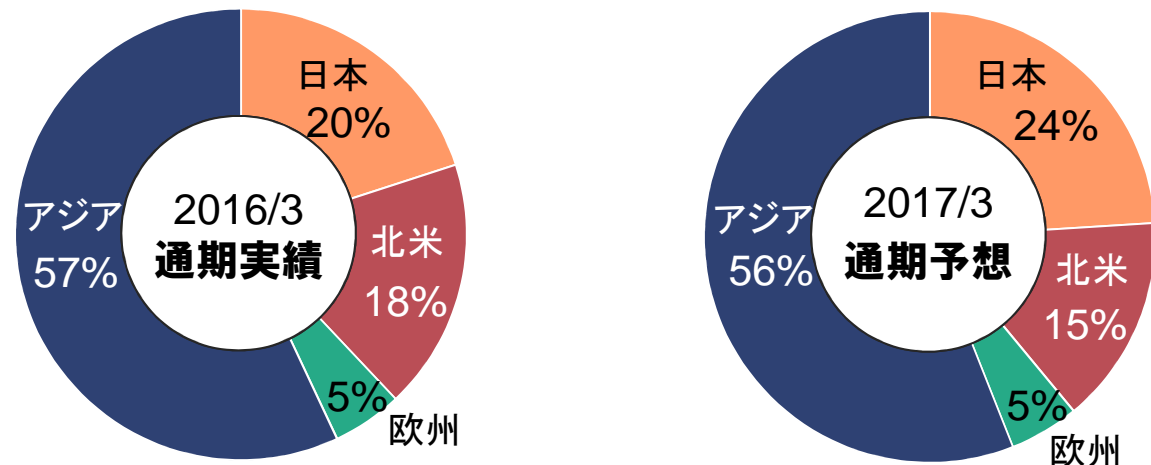
(注) 通期予想から上期実績を差し引いて下期予想としています。

# (ご参考) エレクトロニクス機能材料部門

## エレクトロニクス機能材料の種類別売上構成



## 半導体フォトレジストの地域別売上構成





**トピックス**  
**～tok中期計画2018の取組み～**

# ArFレジスト

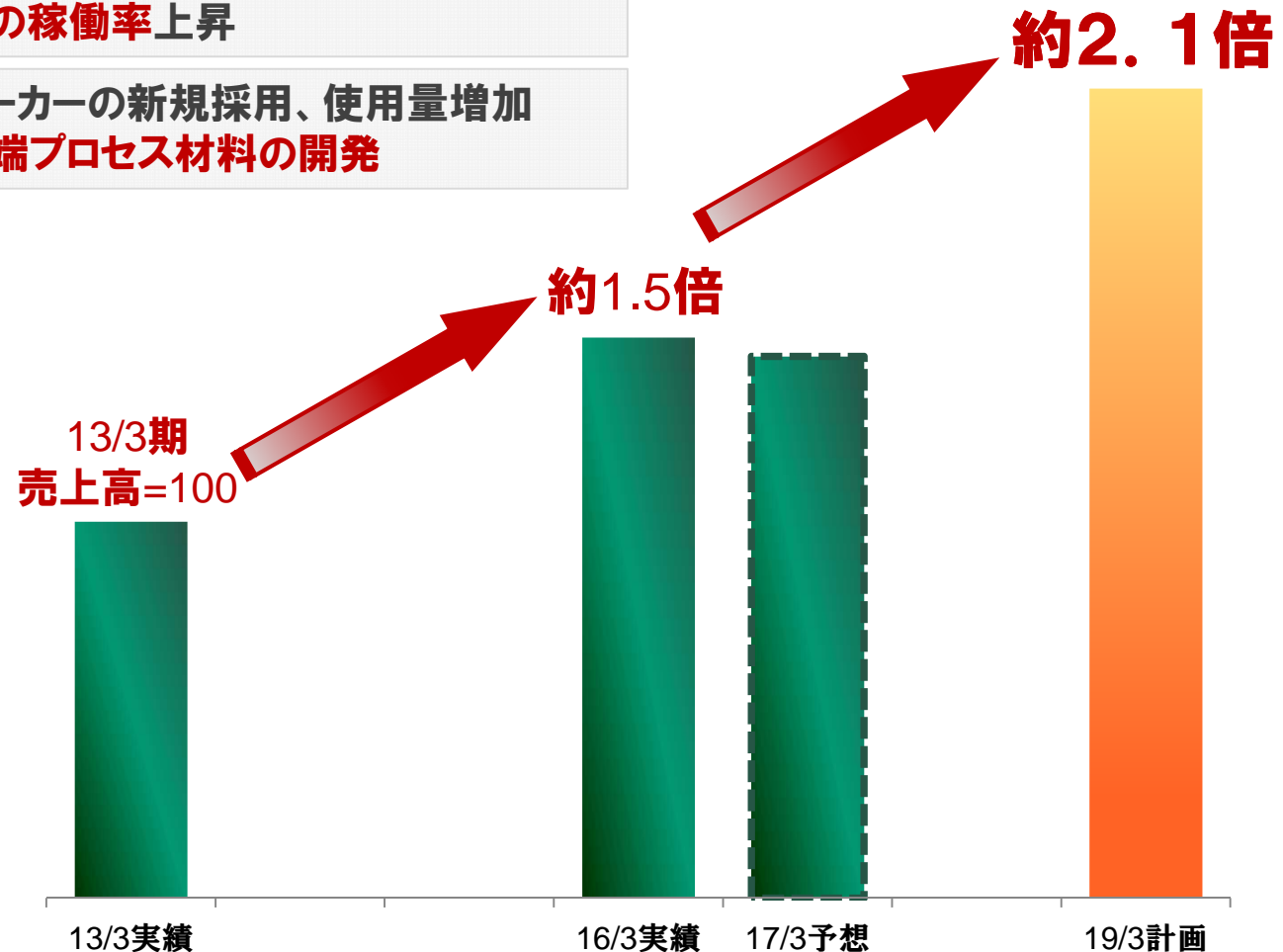
1X世代の需要増、10nm以降の採用獲得

ロジック

- 大手メーカーの新プロセス移行、量産開始  
⇒ 今後の稼働率上昇

メモリ

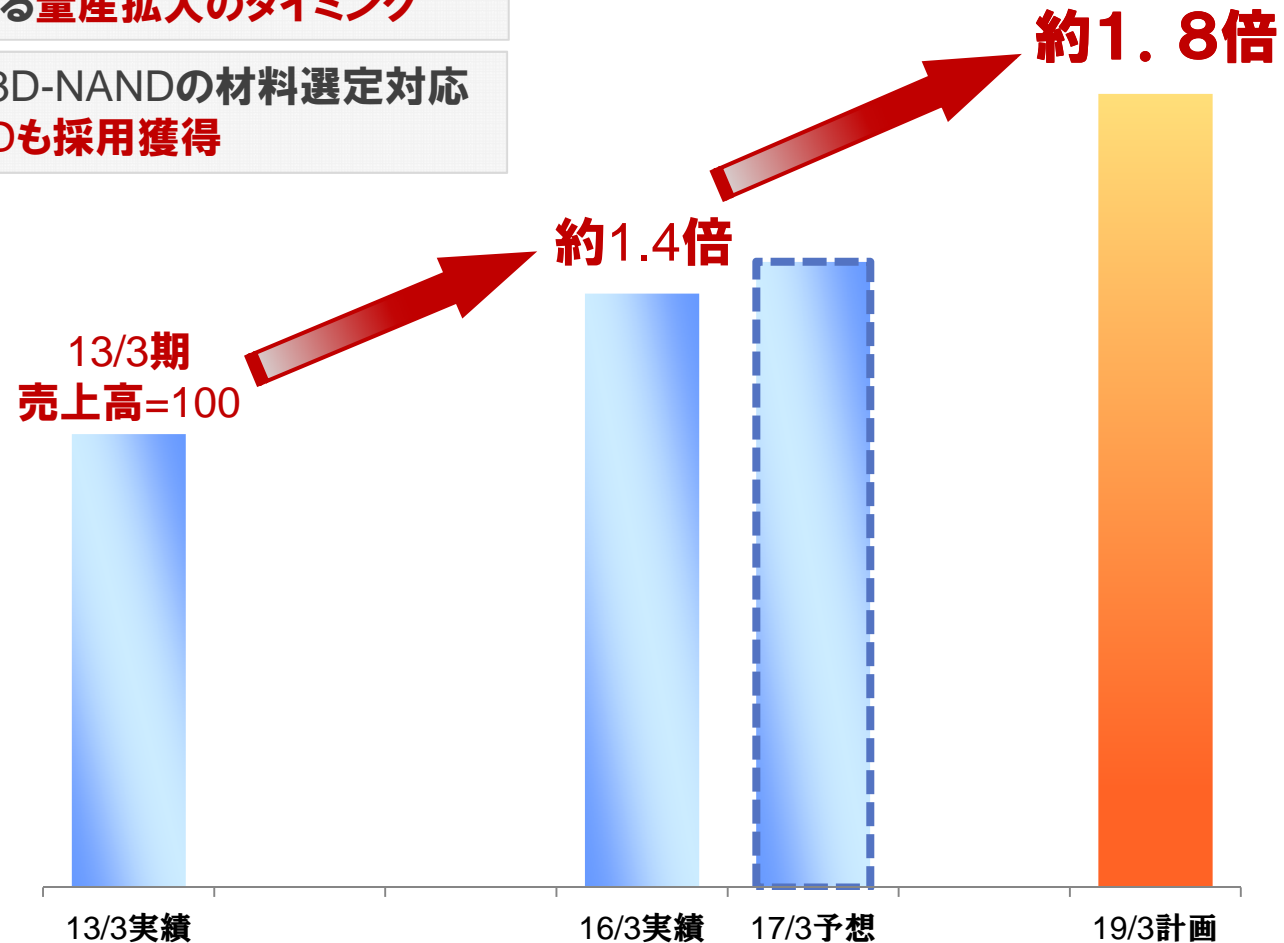
- 大手メーカーの新規採用、使用量増加  
⇒ 最先端プロセス材料の開発



# KrFレジスト

## 3D-NAND向け厚膜レジストの採用拡大

- 大手メーカーの3D-NANDの順調な量産拡大  
⇒他メーカーにおける**量産拡大のタイミング**
- 次世代、次々世代3D-NANDの材料選定対応  
⇒**次世代3D-NANDも採用獲得**



# 高密度実装材料

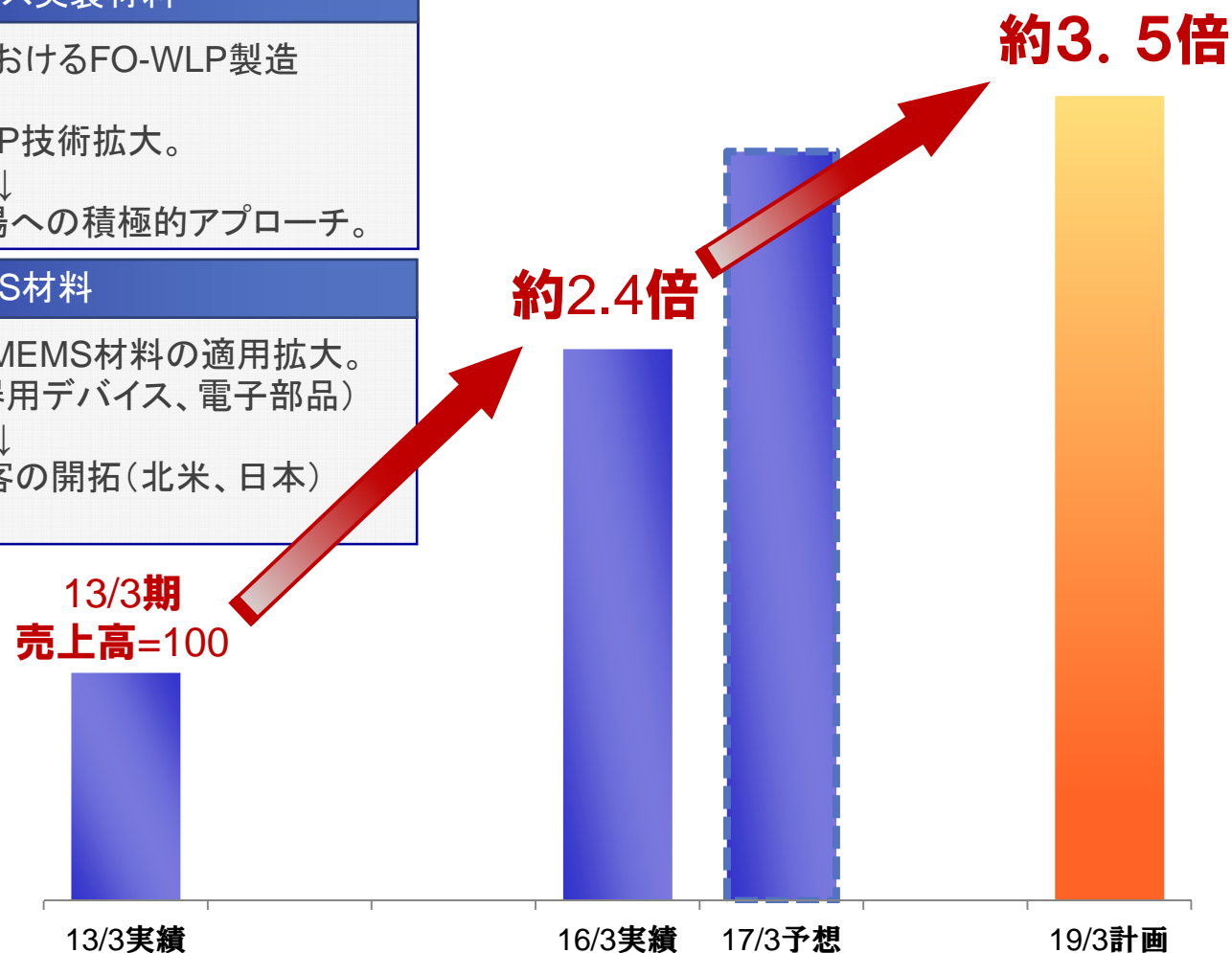
## 新規/先端プロセス用途の供給拡大

### 先端プロセス実装材料

- ハイエンドスマホAPIにおけるFO-WLP製造プロセスにて採用。
- 次世代メモリとFO-WLP技術拡大。
- 韓国、台湾、中国市場への積極的アプローチ。

### MEMS材料

- 電子部品等におけるMEMS材料の適用拡大。(各種センサ、通信機器用デバイス、電子部品)
- 新規ニーズ、新規顧客の開拓(北米、日本)
- 欧州市場開拓



<http://www.tok.co.jp/>

**（ご注意）**

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。